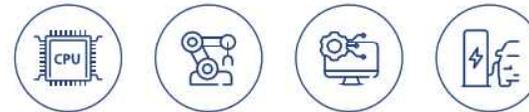


Investor Relations 2024

에이치엔에스 하이텍



CONTENTS

Chapter 01

에이치엔에스 하이텍

- 기업개요
- 회사연혁
- 사업영역
- 고객사 현황

Chapter 02

사업 소개

- 소재사업부
- 전자사업부
- 성장전략

Chapter 03

IR Focus

- ※ Summary
- 우호적인 시장 패러다임
- 차별화된 기술력
- 업계 선도 제품 경쟁력
- Global Top tier 고객사
- 미래 성장동력 사업
- 매력적인 경영실적 시현

Chapter 04

경영 실적

- 매출실적
- 경영실적
- 요약 재무제표

Disclaimer

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자자의 이해를 증진시키고 투자판단에 참고가 되는 각종 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 본 자료를 작성하는데 있어 최대한 객관적인 사실에 기초하였습니다.

그러나 현 시점에서 회사의 계획, 추정, 예상 등을 포함하는 미래에 관한 사항들은 실제 결과와는 다르게 나타날 수 있고, 회사는 제반 정보의 정확성과 완전함을 보장할 수 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 공시를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.

01 Chapter

에이치엔에스 하이텍

1. 기업개요
2. 회사연혁
3. 사업영역
4. 고객사 현황



01. 기업개요

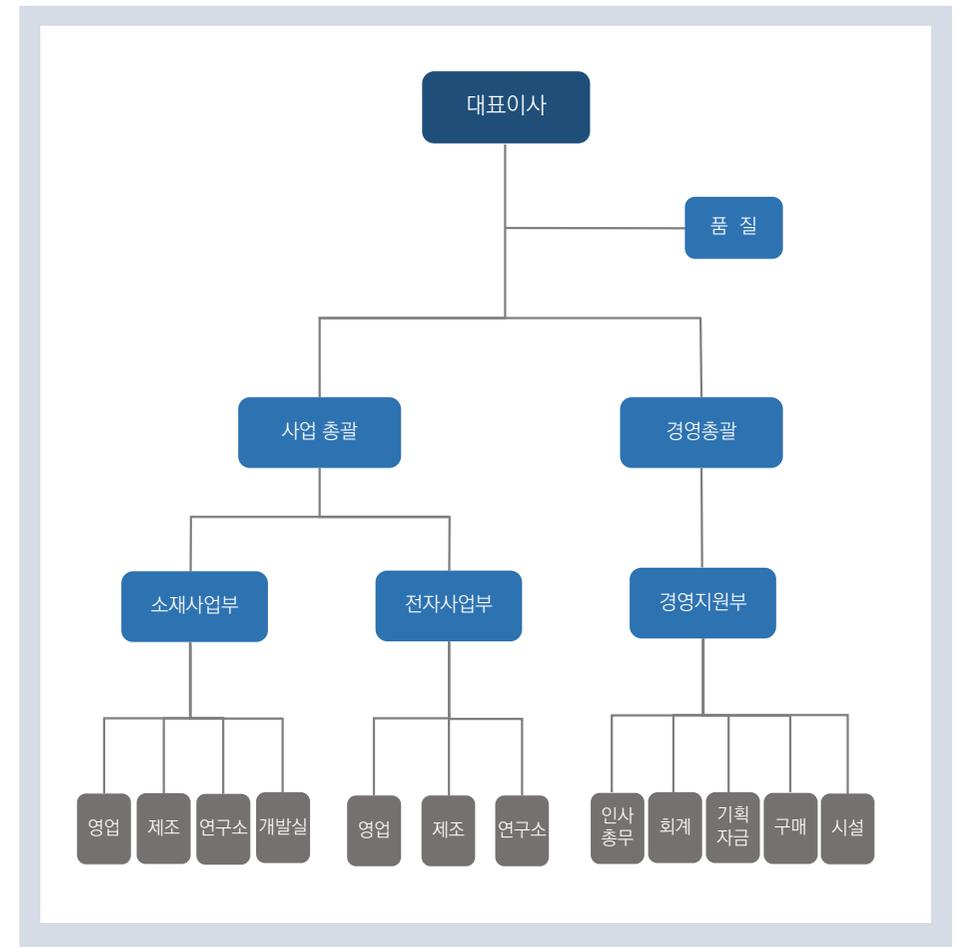
접합소재 전문 기업, 에이치엔에스하이텍

/// 일반 현황

회사명	에이치엔에스하이텍(주) (H&SHighTech Corp.)	설립일	1995.12
대표이사	김정희	임직원	174명
사업영역	전자통신부품 제조, 판매 / 반도체 제품 개발, 공급		
자본금	4,018백만원		
조직구성	소재사업부, 전자사업부		
소재지	- 본사: 대전광역시 유성구 테크노 1로 62-7 - 안산지점: 경기도 안산시 단원구 해안로 73		
홈페이지	www.hnshightech.com		

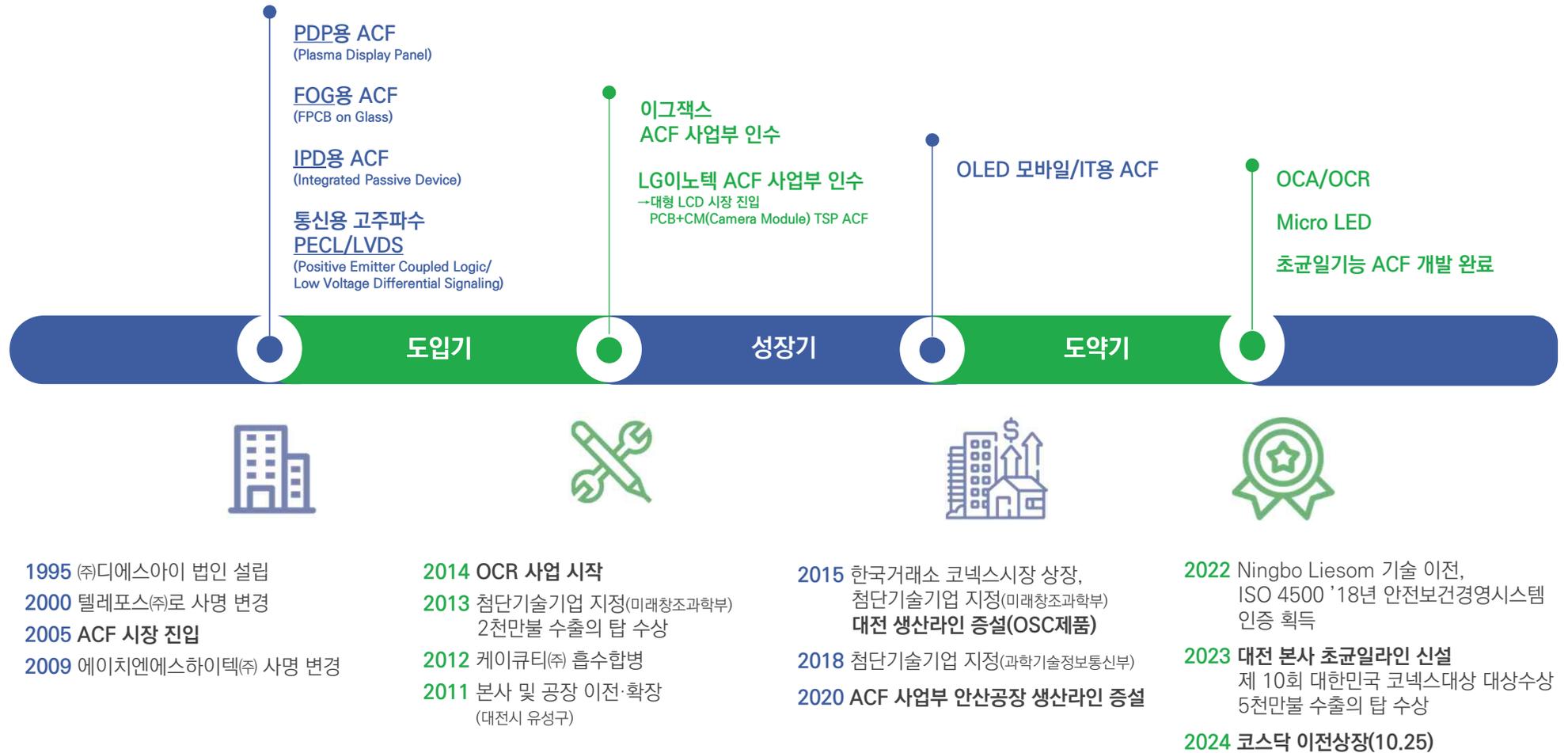
- 임직원 및 자본금은 '24년 10월 말 기준

/// 조직도



02. 회사연혁

국산화를 통한 기술 경쟁력 확보로 지속 성장 중



지식재산권

특허 : 국내 11건/해외 6건 총 17건 등록 | 상표권 : 23건

03. 사업영역

축적된 기술력으로 탄탄한 사업 기반 구축



04. 고객사 현황

글로벌 기업 중심의 다수 고객사 보유

ACF				수정 진동자/발진기	

02 Chapter

사업 소개

1. 소재사업부
2. 전자사업부
3. 성장전략



01. 소재사업부

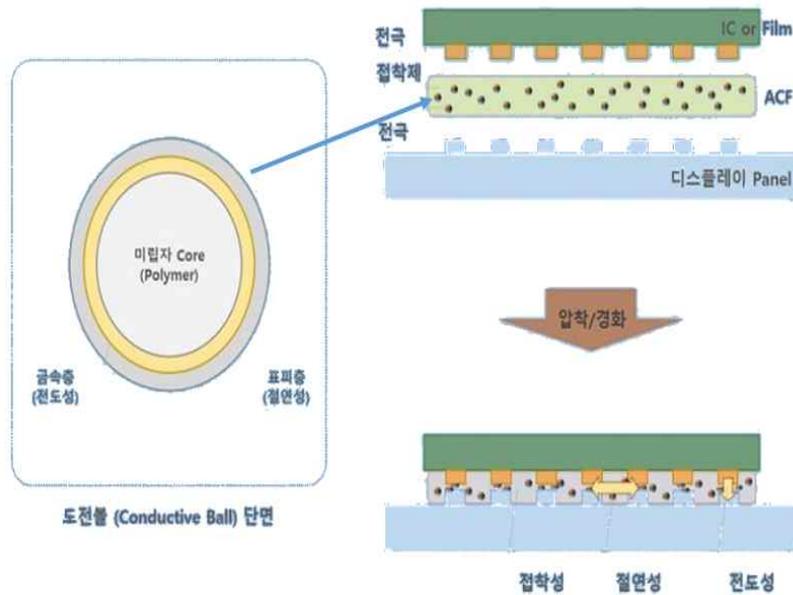
Display 등의 패널과 회로의 접속을 위한 필수 소재

/// ACF 기술의 개요

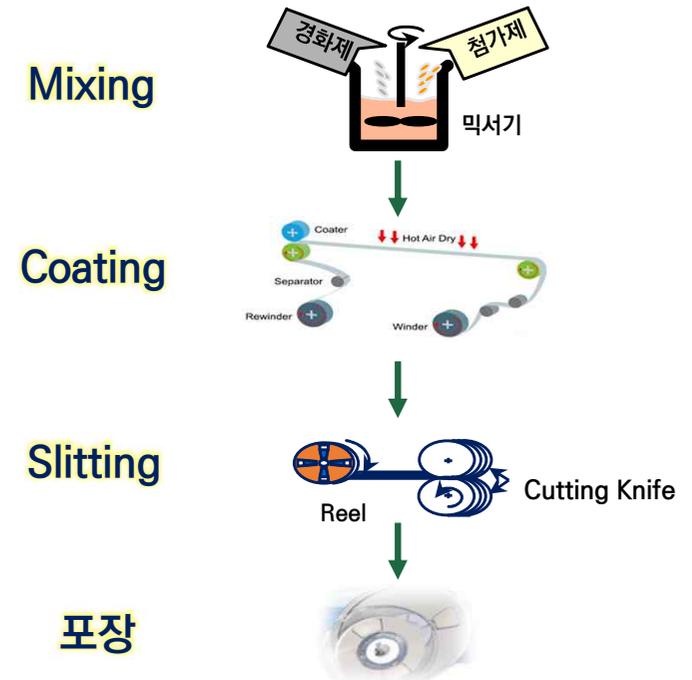
Anisotropic Conductive Film

이방성 도전 필름의 약어로 LCD Panel Glass나 COF(Chip On Film)에 IC를 Bonding, 혹은 Glass에 TCP(Tape Carrier Package)를 Bonding 할 경우 사용되는 접착 및 통전재료로 반도체 실장에 많이 사용되는 대표적인 재료

[ACF 구조 및 접속 원리]



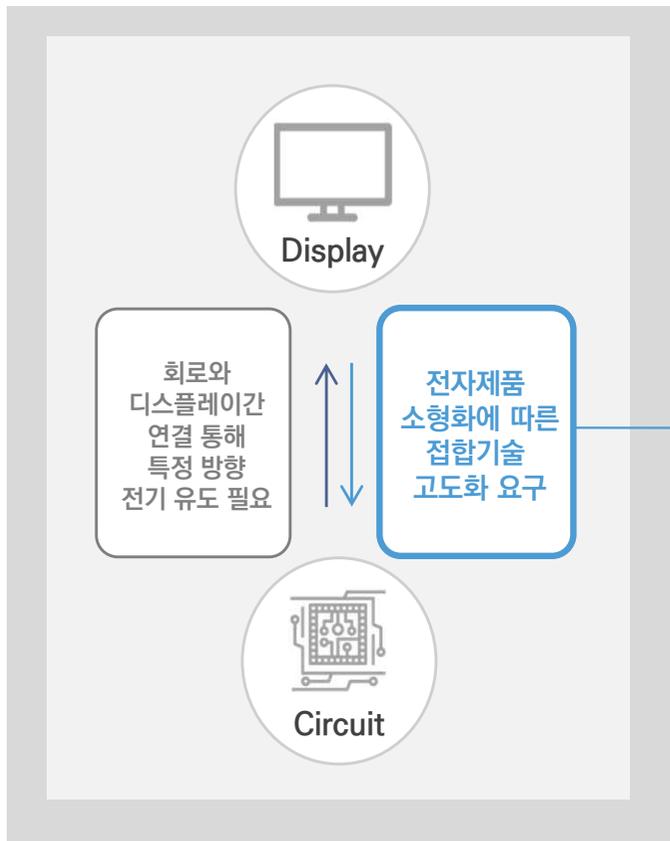
[제조 공정도]



01. 소재사업부

‘부품 소형화’에 대한 시장 Needs 충족 접합기술은 Fine Pitch 가능한 ACF가 유일

/// 시장 요구사항



/// 기술 비교

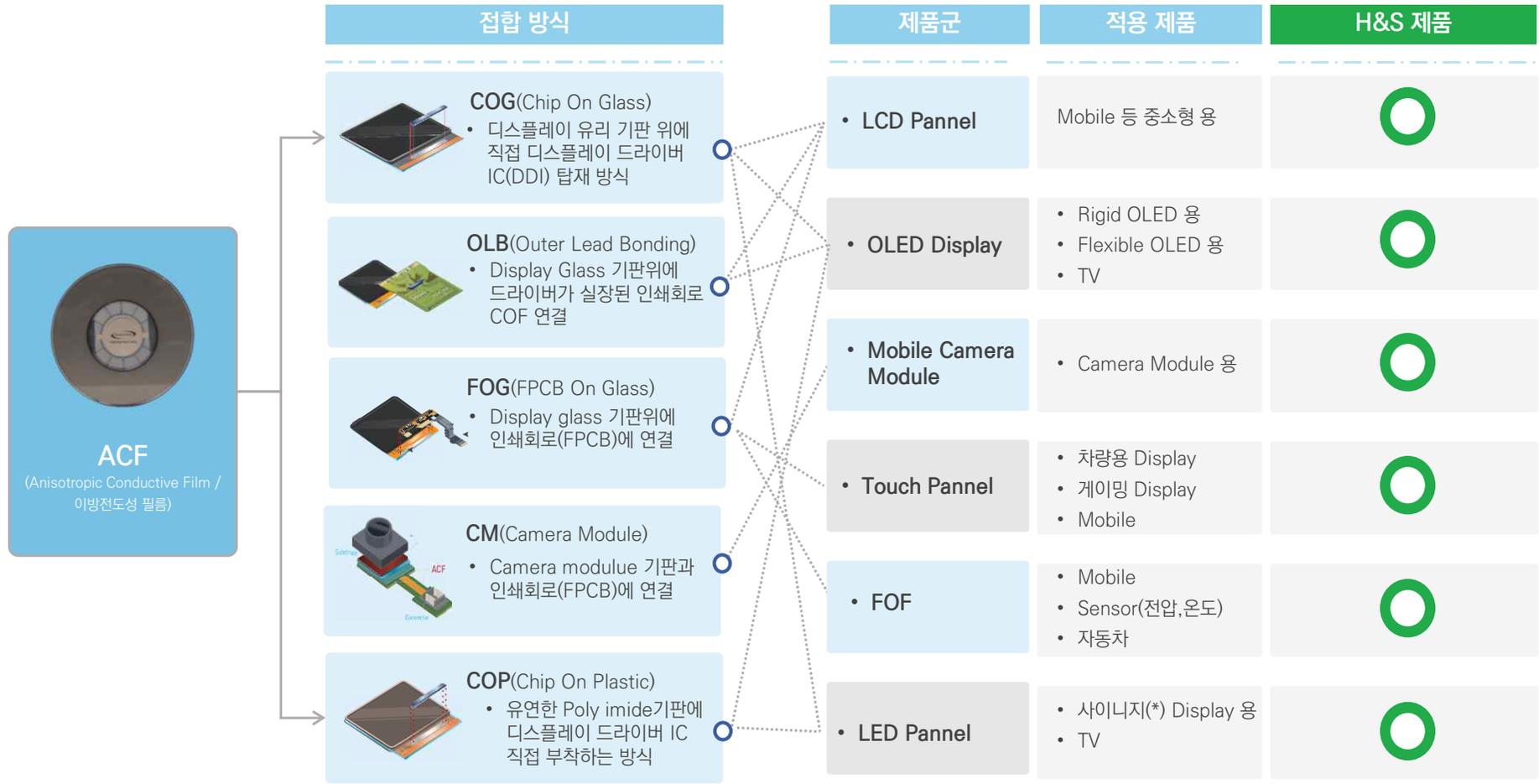
구분	SMT(**)	커넥터	ACF
두께	상	중	최상
전도성	상	중상	상
접착성 (신뢰성)	상	불가능 (기구적 체결 가능)	상
Fine Pitch(*)	불가능	불가능	가능
가격경쟁력	하	중상	상
주 적용제품	범용 전자 제품	좌동	고해상도 디스플레이/ 카메라 모듈 Sensor 등
참여 기업(개사)	다수	좌동	극소수

* Fine Pitch: 미세 집적회로의 리드(칩셋과 외부 회로 연결 전선) 사이의 미세한 간격
 ** SMT(Surface Mount Technology): 표면 실장형 부품을 전자회로에 부착시키는 방법

01. 소재사업부

IT 제품 고도화 필수 부품으로 제품 특성에 따른 다양한 접합 방식 적용

/// ACF 접합방식 비교



* 사이니지(Signage): 인도어, 아웃도어용 Display (Ex. 지하철, Shop, 건물 외부)

01. 소재사업부 - 제품 및 매출 현황

다양한 제품군에 따른 안정적인 매출 달성

Business Flow

[제품별 매출]

모바일 카메라 모듈용(60%)

저온 속경화 타입으로 다양한 기재 (Ceramic 및 FR-4)에 높은 접착력 부여

모바일, TV, 모니터용(22%)

극미세피치 COG, FOF 접속용 나노파이버 ACF 제품
NFA 저유동 ACF 제품

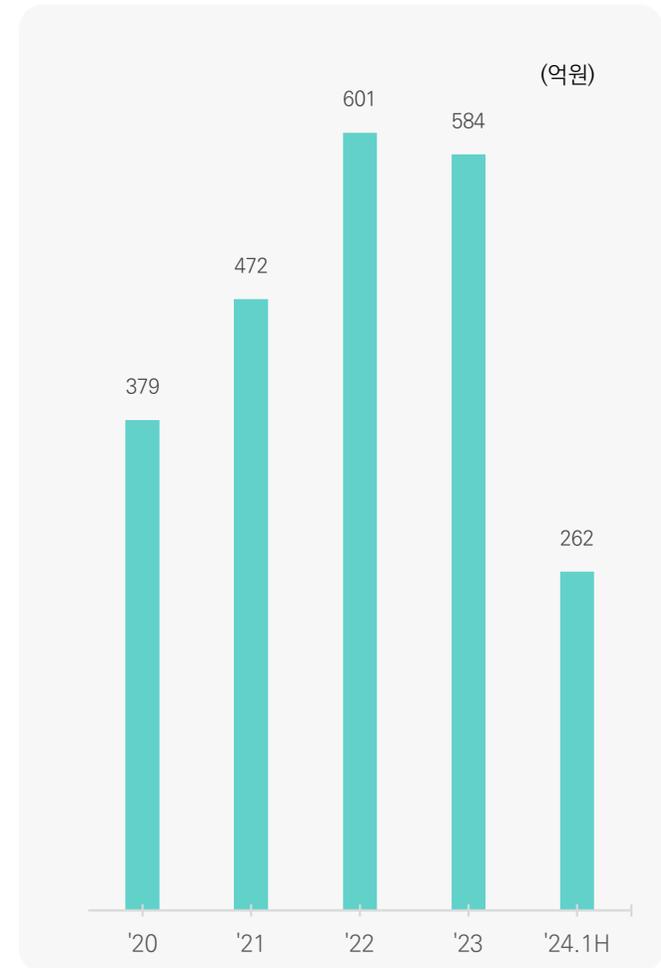
기타(18%)

[핵심 거래처]

LG Innotek
SHARP
COWELL

LG Display SAMSUNG
CSOT LG전자
BOE TCL

매출추이



* ()는 '23년 매출 비중

02. 전자사업부

모든 전자제품의 핵심 부품, 수정 진동자/발진기

// 제품 개요와 H&S

수정진동자 (Crystal Unit) 리드 (Lid)

발진회로 (oscillator IC) 세라믹 패키지 (Ceramic Package)

+ 고객 Needs

수정발진기
(XO Crystal Oscillator)

전압 제어 수정발진기
(VCXO Voltage Controlled Crystal Oscillator)

온도 보상 수정발진기
(TCXO Temperature Compensated Crystal Oscillator)

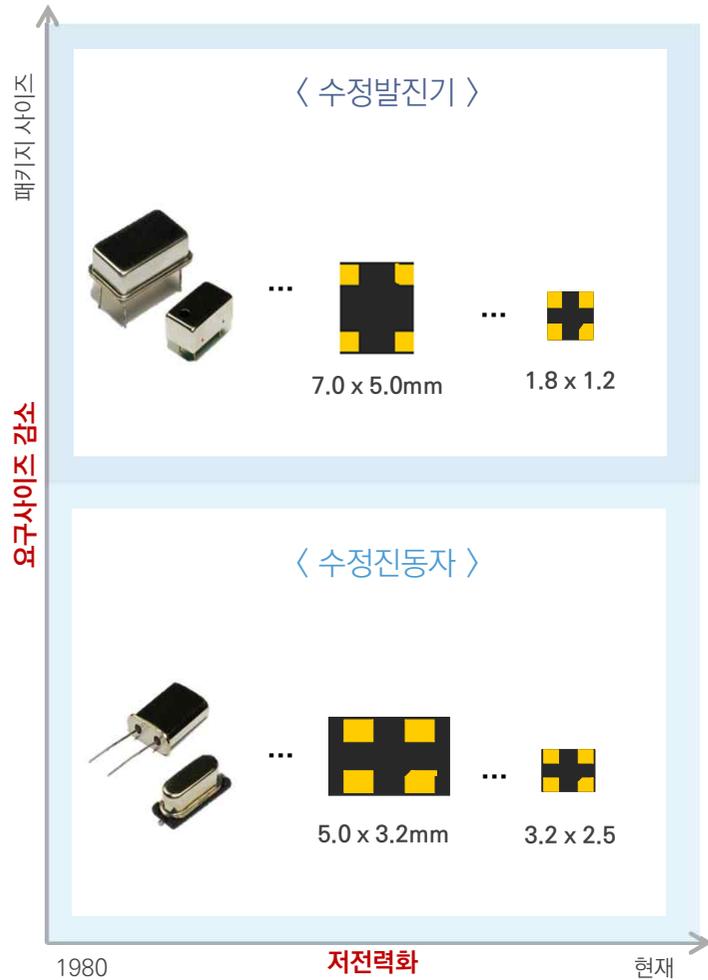
항온기 부착 수정발진기
(OCXO Oven Controlled Crystal Oscillator)

제품군	적용 제품	H&S 제품
 통신용	<ul style="list-style-type: none"> 무선통신 광통신 중계기 데이터센터 	
 차량용	<ul style="list-style-type: none"> 첨단 운전자 지원시스템 인포테인먼트 이더넷 라이다/레이더 	
 Home / Office용	<ul style="list-style-type: none"> 스마트홈/IoT 게임콘솔 비디오/오디오 웨어러블 	
 산업용	<ul style="list-style-type: none"> 공장자동화 산업용 로봇 스마트시티 검사 및 계측기 	

02. 전자사업부 – 제품 및 매출 현황

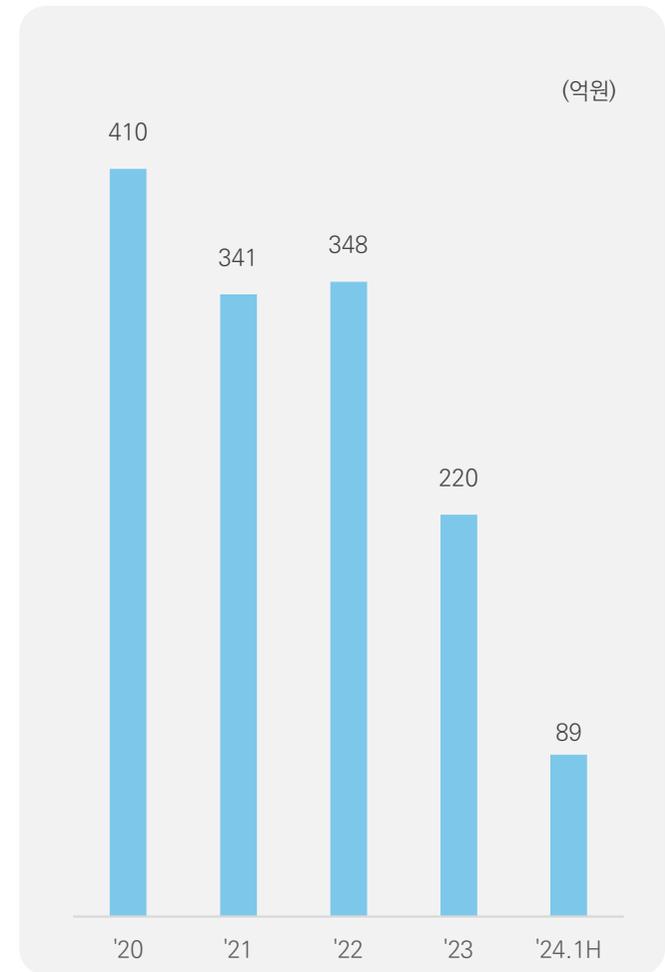
시장 Needs에 최적화된 고부가가치 제품 생산

/// 시장 요구사항과 H&S



구분	기존 중국업체	H&S
초소화 사이즈 제작 능력	상	상
제품 맞춤형 최적화 주파수 생산	중 (획일화된 제품 라인업)	최상 (커스터마이징 가능)
Price	중하	상/중/하 (다양한 마켓)
성능 (고정밀/ 고성능성)	중	상

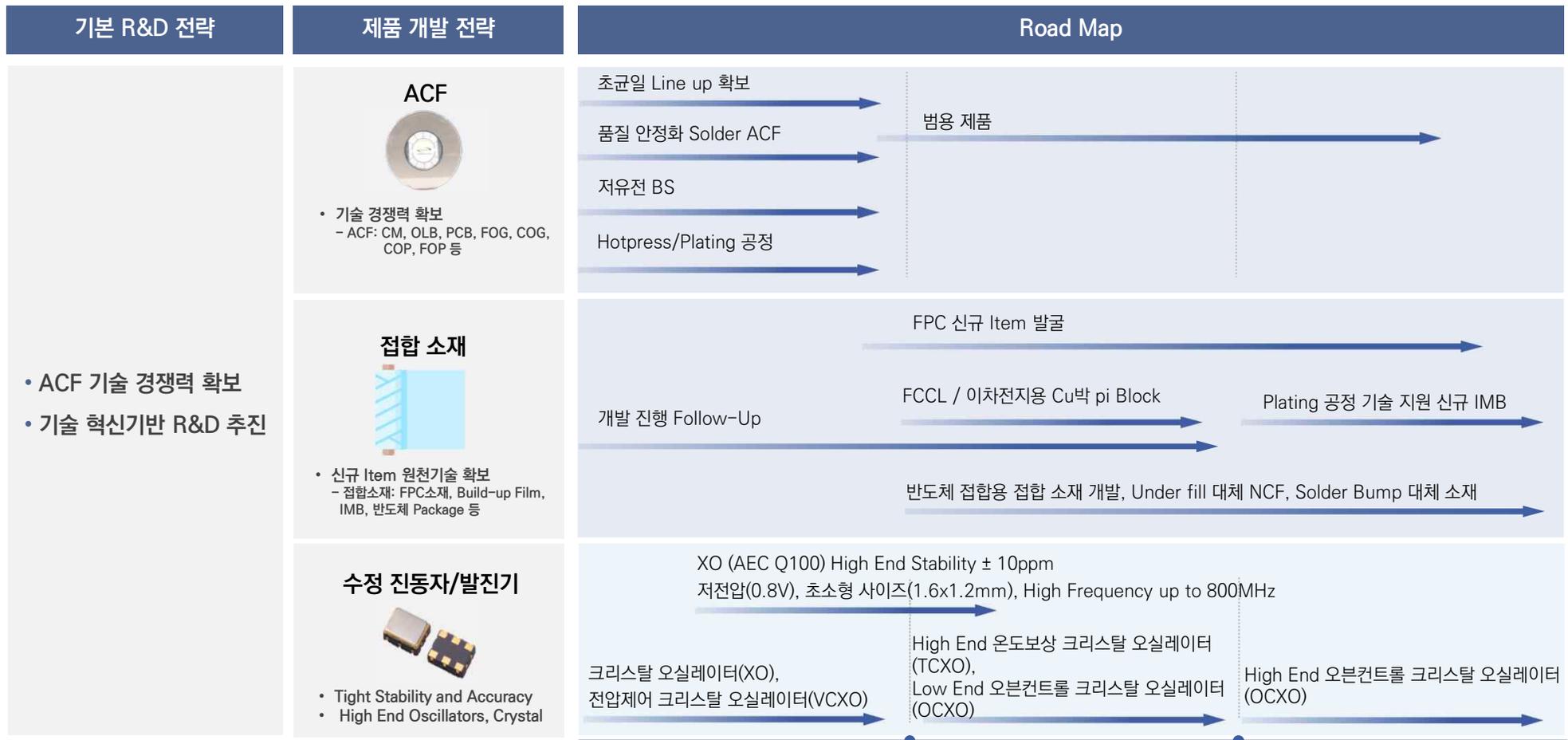
/// 매출추이



03. 성장전략 - (1)_R&D 전략

제품 기술 고도화 및 신규 제품 원천기술 확보

R&D 전략 및 Road Map



03. 성장전략 - (2)_사업확대 전략

사업성과 시너지 효과 기반 사업확대 추진 ... ACF > +수정 진동자/발진기 > +접합소재

// 단계별 사업확대 전략

	사업 개시	+ M&A	+ 사업 고도화	+ 신규 사업
 <p>주요 사업 확대 Facts</p>	<ul style="list-style-type: none"> KAIST와 협업 통한 ACF 국산화 <p>→ ACF 시장진입</p>	<ul style="list-style-type: none"> (주)이그잭스 ACF 사업부 인수 케이큐티(주) 흡수합병 LG이노텍(주) ACF 사업부 인수 <p>→ 대형 ACF 시장진입</p>	<ul style="list-style-type: none"> 기술 고도화 글로벌 Top-tier 고객사 확보 <p>→ 국내 M/S 1위 유지 → 글로벌 M/S 확대</p>	<ul style="list-style-type: none"> 접합소재 응용 확대 기판/PKG 소재 적용 검토 <p>→ 기존사업 시너지 효과 극대화</p>
 <p>주요 제품</p>	<ul style="list-style-type: none"> Film on Glass용 ACF LG전자 向 PDP용 ACF 	<ul style="list-style-type: none"> ACF 신규제품 라인업 - 대형 LCD / Touch용 등 수정 진동자/발진기 	<ul style="list-style-type: none"> Micro LED용 ACF Automobile용 ACF Mobile용 ACF 초미세(ACF) 정밀주파수(수정진동자) 	<ul style="list-style-type: none"> OLB FOG IMB Build-Up Film

03. 성장전략 - (3)_신규 사업계획

시너지 효과 큰 접착소재 사업화 가시권 진입

/// 사업진출 현황 및 경영계획



[신규 Item]

제품 개발 완료 후 L사 양산 승인 완료

OCR(Optically Clear Resin)
 휘도 향상 UV 경화형 접착제
OCA(Optically Clear Adhesive)
 투명 광학부품용 특수 접착제



자동차용 디스플레이

제품 개발 완료 양산 중

Micro LED
 초균일기능 적용 ACF



모바일 /Tablet/TV

내부 개발 완료 후 Promotion 진행 중

반도체 PKG 소재
 절연 접착제 기반
 반도체 회로 접속 및 접합제



반도체

소재 개발 통한 사업 확장 추진 중

Build-up Film
 FC-BGA 기판 제작하는 절연성 접착 필름



FC - BGA

합성기술 확보 및 사업화 검토

IMB(Interface Molecular Bonding)
 자재 접착력 높여주는 기능 부여
 표면 처리제



구리 도금 접합 소재

[시장 규모]

2조 5,788 억

* Allie Market, Optically Clear Adhesive Market by Resin Type

1조 2,894억

* Global Information

95조원

* TECHCET

6,000 억원

* H&S 자체 조사

6,000 억원

* H&S 자체 조사

* 시장규모는 글로벌 기준

03 Chapter

IR Focus

※ Summary

1. 우호적인 시장 패러다임
2. 차별화된 기술력
3. 업계 선도 제품 경쟁력
4. Global Top tier 고객사
5. 미래성장동력 사업
6. 매력적인 경영실적 시현



※ Summary

기술력과 제품경쟁력 확보, 최근 5년간 20% 내외 OPM 달성

/// 핵심 투자포인트

01 우호적인 시장 패러다임 전개

- High Quality Display 수요 ↑
 - 경박 단소화 ACF 수요 증가
- IT 제품 소형화 Needs ↑
 - 수정 진동자/발진기 패키지 소형화 필요성 증가



02 차별화된 기술력 보유

- 초균일 기술 : 도전볼 사용량 약 60% 감소
- Fine Pitch : 0.25mm 이하 극소형 리드 피치 대응 가능

03 업계 선도 제품경쟁력 확보

- ACF : 고품질/타 공법 대비 높은 가격경쟁력
- 수정 진동자/발진기 : 최대 1.6x1.2 mm / 800Mhz Range

04 Global Top-tier 고객사 다수 확보

- 최근 5년간 Global Top-tier기업 매출비중 평균 59%

05 미래 성장동력 사업 본격화

- OCR & OCA ('26년) / Build-Up Film ('27년) / IMB ('27년)

06 매력적인 경영실적 시현

- 안정적 Cash Cow 확보
 - 5년간 매출 16.2% / 영업이익 68.4% 성장



투자 매력도

01. 우호적인 시장 패러다임

고기능 제품 수요 시장 가속화로 업계 선도 기술 및 제품경쟁력 보유 H&S 수혜

/// 제품별 시장 패러다임과 H&S

ACF (Anisotropic Conductive Film)

[Display Market Trend]

- 고품질 Display 기술 수요 ↑
⇒ **경박 단소화**

〈OLED〉

'21: 27.3% (430억 달러)
'27: 37.6% (517억 달러)
10.3%p↑

〈대형 디스플레이〉

'21: 42.5% (667억 달러)
'27: 73.3% (854억 달러)
30.8%p↑

[H&S Positioning]

- Global Top-tier 기술력 / 고객사 보유
- PCB, CM, Touch, uLED용 World Best ACF 확보
- 국내 1위 / 글로벌 3위 M/S

- 업계 최고 기술력 보유
- 높은 고객 대응력
- 국내 기업 1위 / R&D 지속 투자

수정 진동자/발진기

[Global IT Trend]

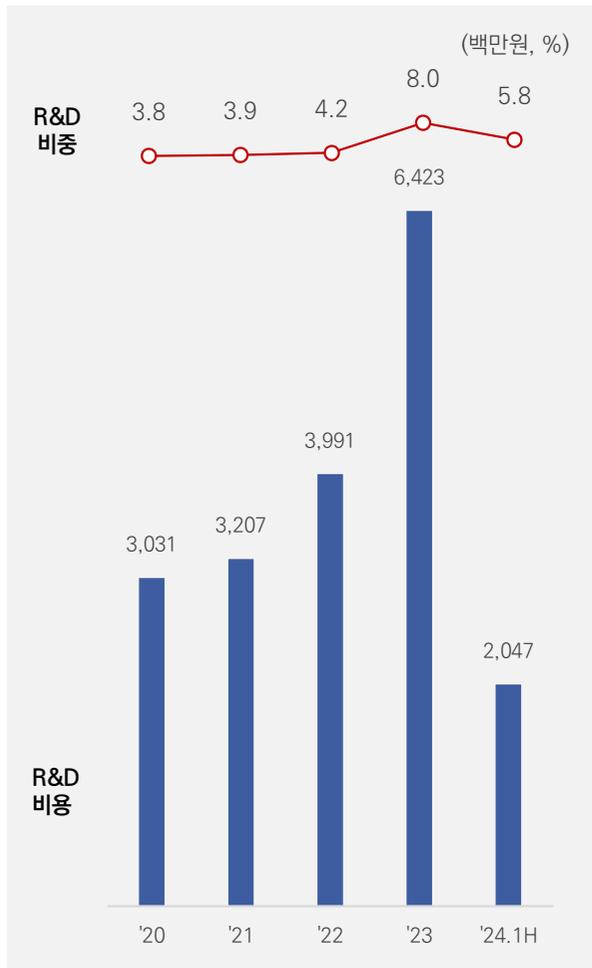
- IT 기기 크기 ↓
⇒ **소형화 및 저전력화 수요 증가**

* 출처: 한국디스플레이산업협회

02. 차별화된 기술력

시장 Needs 대응 가능 기술력 확보

R&D 투자



* 주요 비중은 '23년 기준

[주요 비중]



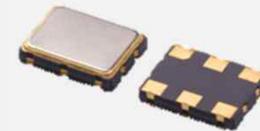
핵심 보유기술

- **Solderable NCF**
 - 저용점 솔더 적용 통한 접속저항 개선
- **Slitting**
 - 고객의 사용폭으로 Cutting, Winding 동시 진행
- **NFA(Non-flow ACF)**
 - 포착률 60%수준 확보
 - Short Risk 최소화, 절연 Gap 6um
- **Solder ACF**
 - 저압에서도 안정적인 접속저항 유지
- **초균일**
 - 도전볼 사용량 약 60% 감소
 - 대면적의 Sheet, Roll 원단 대응 가능
- **Fine-pitch**
 - 0.25mm 이하 리드 피치 대응 가능

[ACF]



[수정 진동자/발진기]



[지적재산권]

특허 **17건**
(국내 11건/해외 6건)

상표권 **23건**

- Mesa Fundamental Crystal 제조 기술
- 통신용 고주파수 회로출력 Oscillator 제조 기술
- 고안정도/고신뢰성 Oscillator 제조 기술

03. 업계 선도 제품경쟁력

차별화된 제품경쟁력 기반 확고한 시장 지위 구축

// 제품경쟁력 요소

“
국내 M/S 1위,
글로벌 M/S 3위

”



ACF

차별화된 Fine Pattern용
정렬형 ACF 기술 탑재
Customized Design

- Global Top-tier 기술 보유
- World Best Item 다수 보유
- 최소 Pitch 대응 가능

적용제품 경박 단소화

수정 진동자/발진기

고정밀/고신뢰성
Low Phase Noise
소형 사이즈

- 고객 맞춤형 제품 개발/제작
- 주파수 제어 제품에 대한 모든 솔루션 보유

소형화 / 고주파 정밀화

“
국내 기업 1위,
R&D 지속 투자 기업

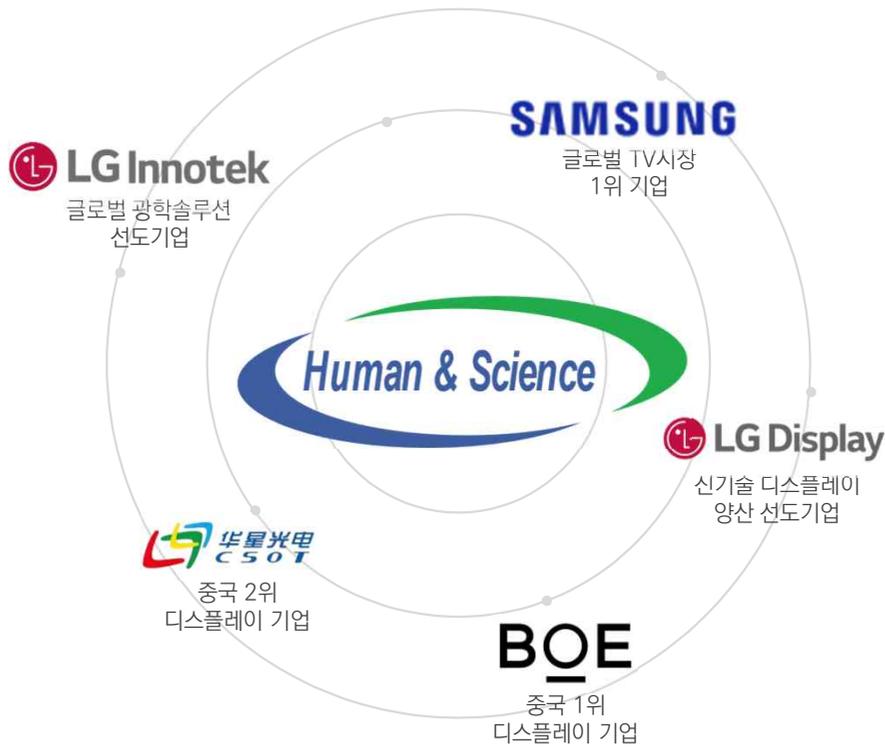
”



04. Global Top-tier 고객사

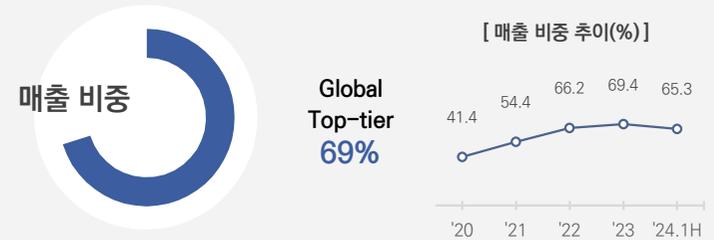
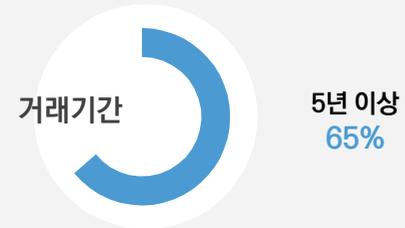
사업 안정성 및 매출확대 기반 확보

Global Top-tier 거래선 현황



* Global Top-tier 기업 H&S 자체 선정

[주요 지표]



* '23년 매출 기준

05. 미래 성장동력 사업

접합소재 등 신규 사업 본격화

/// 사업진행 현황 및 사업화 일정

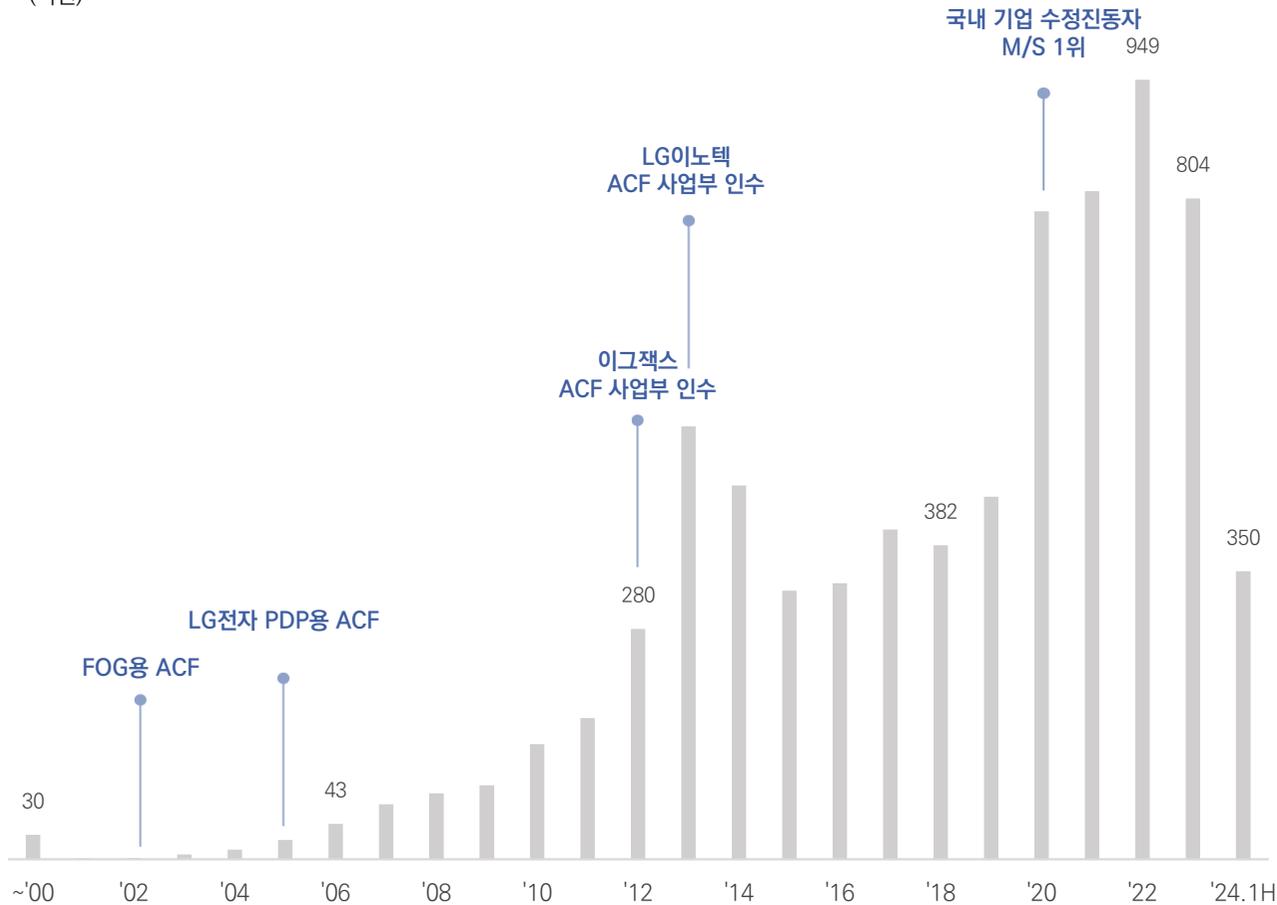


06. 매력적인 경영실적 시현

기술 노하우 축적 기반 우수한 경영지표 달성

/// 경영실적과 이벤트

(억원)



[주요 경영지표]

순자산 949억원	유동비율 906.9%
부채비율 10.7%	
최근 5년간 성장률 16.2%	ROE 33.0%
특허 등록 17건	최근 3년간 평균 EBITDA 179억
	영업이익률 16.3%

* 경영실적 및 재무비율 등은 '24.1H 기준
* ROE 및 영업이익률은 단순연환산

04 Chapter

경영 실적

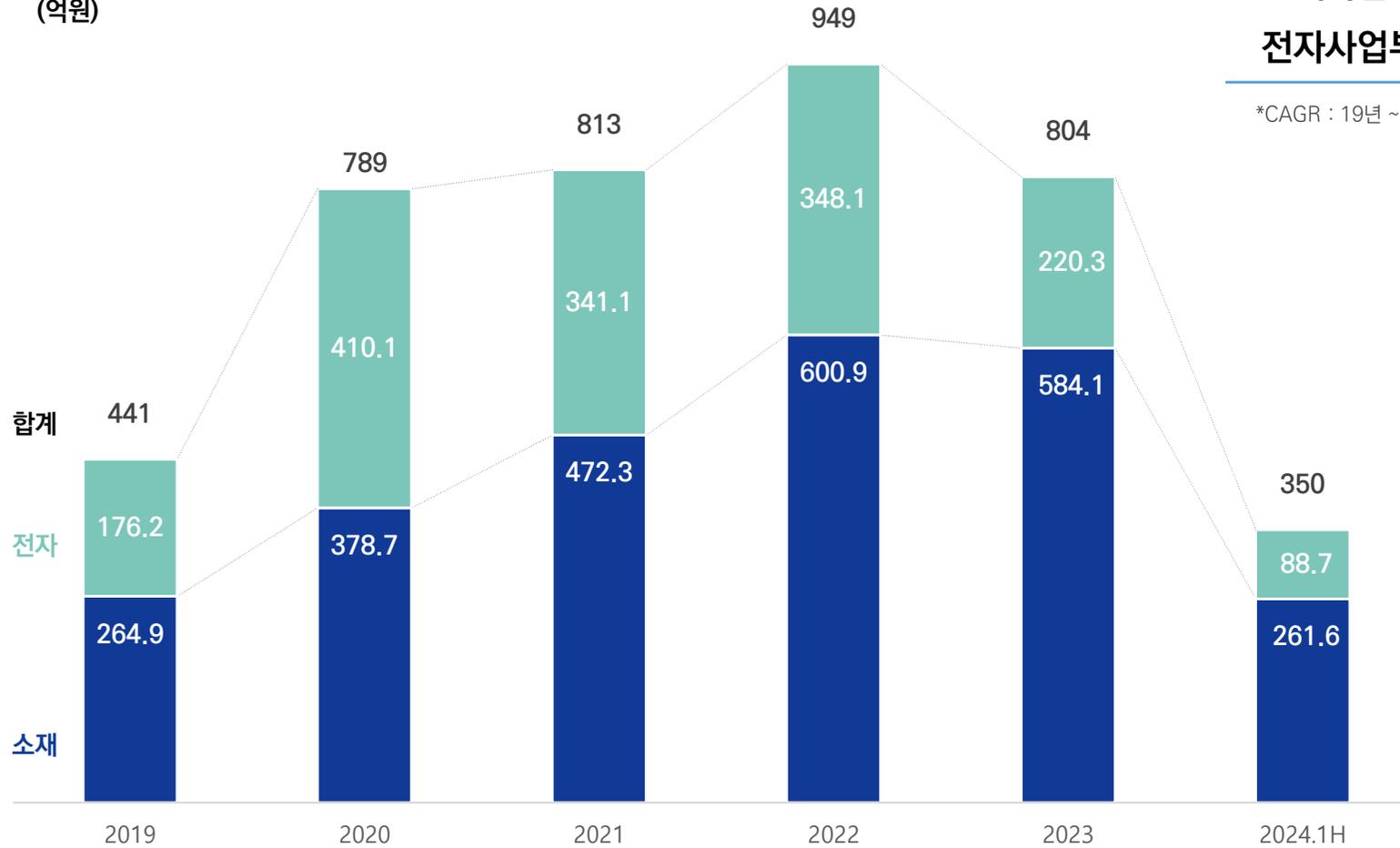
1. 매출실적
2. 경영실적
3. 요약 재무제표



01. 매출실적

매출실적 추이

(억원)



연평균성장률(CAGR)

총 매출	16.2 %
소재사업부	21.9 %
전자사업부	5.7 %

*CAGR : 19년 ~ 23년까지

02. 경영실적

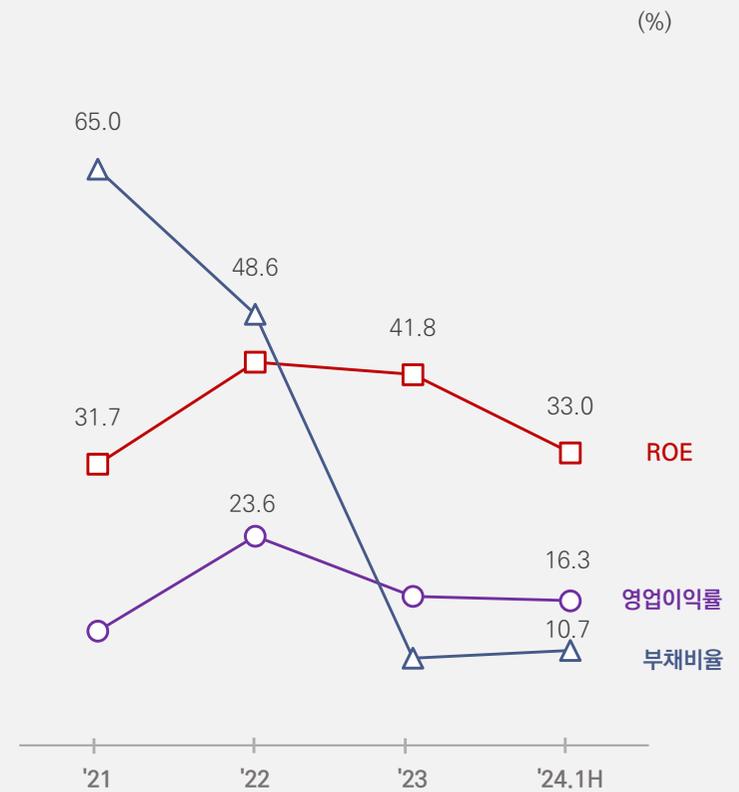
주요 경영성과와 지표

[주요 경영성과]

- 지속 성장 사업모델 구축**
 - 차별화 기술 적용 제품 확대로 Cash cow 확대
 - 접합 / 배합 Know-how 기반 신사업 진출 (Build-up Film 등)
- 업계 선도 기술 및 제품경쟁력 확보**
 - 카메라 모듈용 ACF 글로벌 시장점유율 40%
- 확고한 시장지위 확보**
 - ACF : 국내 시장 1위 / 글로벌 시장 3위 포지셔닝
 - 수정 진동자/발진기 : 국내 기업 1위, R&D 지속 투자
- 양호한 경영실적 시현**
 - 최근 5년간 연평균 매출 16.2% / 영업이익 68.4% 성장
- 시너지 효과 큰 신규사업 가시권 진입**
 - OCA / OCR / PKG용 소재 / IBM / Build-up Film

- 업계 선도 지위 확보
- 안정적 Cash-Cow 창출
- 신규사업 추진 동력 확보

[주요 경영지표]



* '24.1H 수치는 단순연환산 기준

03. 요약 재무제표

/// 요약 재무상태표

(억원)

구분	2021	2022	2023	2024.1H
유동자산	545	584	600	665
비유동자산	199	306	383	386
자산총계	744	890	983	1,051
유동부채	273	269	68	73
비유동부채	83	23	20	28
부채총계	356	291	88	102
자본금	38	38	38	38
이익잉여금	351	561	857	911
자본총계	388	599	895	949

* K-IFRS 별도기준

/// 요약 손익계산서

(억원)

구분	2021	2022	2023	2024.1H
매출액	813	949	804	350
소재사업부	472	601	584	261
전자사업부	341	348	220	89
매출원가	579	553	448	195
매출총이익	234	396	356	155
판매비와관리비	129	172	221	98
영업이익	105	224	135	57
영업외수익	39	53	235	34
영업외비용	30	42	19	2
법인세차감전 순이익	114	235	352	89
법인세비용	13	22	39	13
당기순이익	102	213	312	76

* K-IFRS 별도기준

감사합니다

2024년 11월 21일



에이치엔에스하이텍 주식회사

본 사) 대전광역시 유성구 테크노 1로 62-7
안산공장) 경기도 안산시 단원구 해안로 73

T. 042-866-1300

F.042-867-1308

<http://www.hnshightech.com>